



Electronics for the Future

決算発表 補足資料

2024年度 第1四半期業績

2024年8月5日
ローム株式会社
広報IR部

2024年度 第1四半期 実績 業績報告 (前年同期比)

(単位：億円)

	FY2024 第1四半期 実績	FY2023 第1四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,182	1,201	▲19	▲1.6%
営業利益	12	176	▲164	▲92.8%
(対売上比率)	(1.1%)	(14.7%)	-	-
経常利益	92	280	▲188	▲67.0%
(対売上比率)	(7.8%)	(23.3%)	-	-
純利益	34	201	▲167	▲82.8%
(対売上比率)	(2.9%)	(16.8%)	-	-
EBITDA	210	326	▲116	▲35.6%
(対売上比率)	(17.8%)	(27.2%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (156.53円) (138.11円)

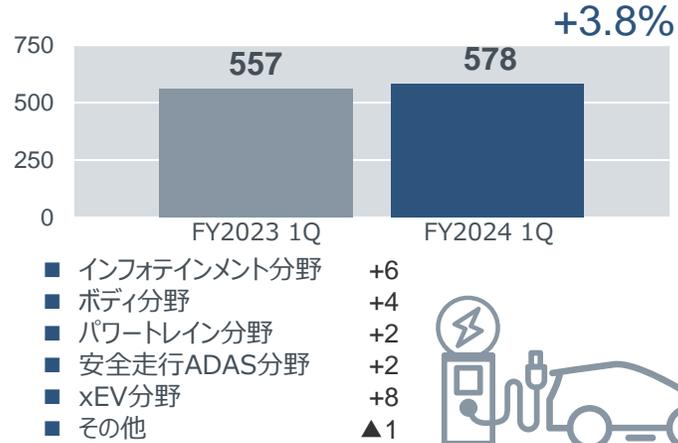
期末レート(¥/US\$) (161.07円) (144.99円)

(単位：億円)

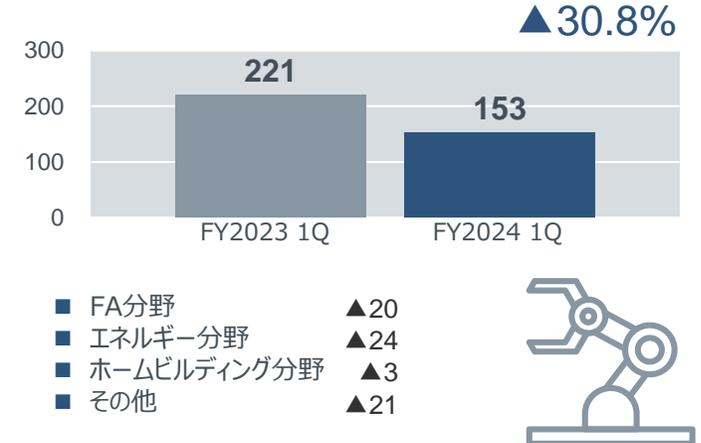
四半期売上高



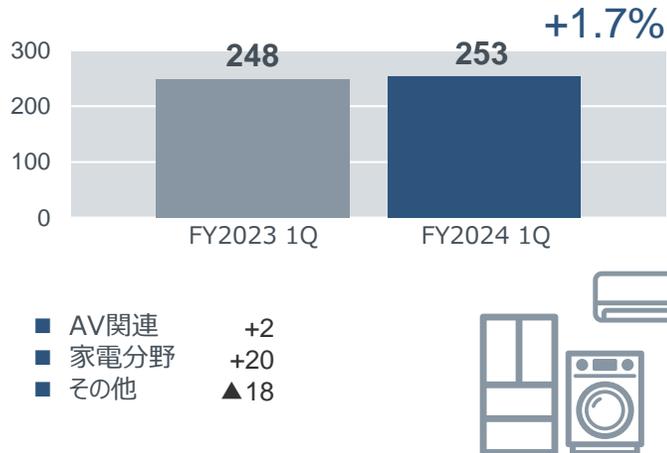
自動車



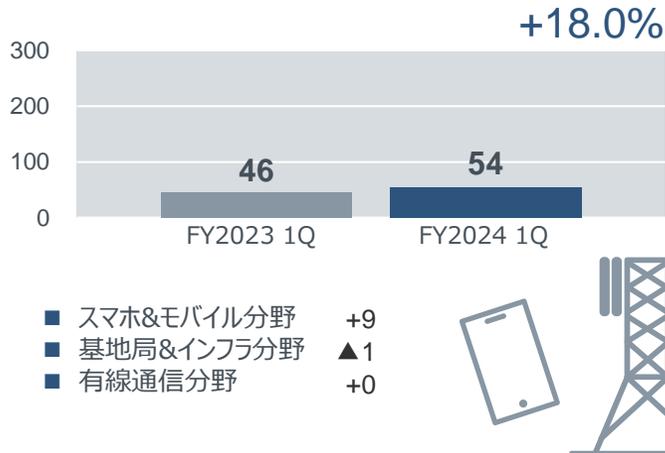
産機



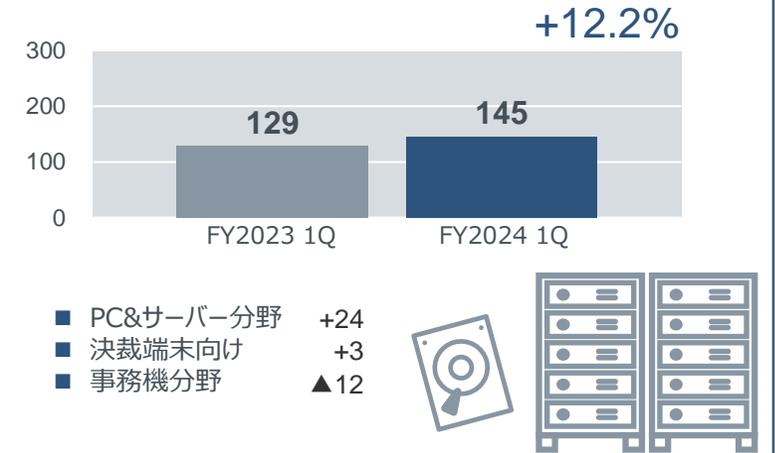
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2024年度 第1四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

四半期売上高

1,201億円

1,182億円

FY2023 第1四半期実績

FY2024 第1四半期実績

▲1.6%

海外売上高比率

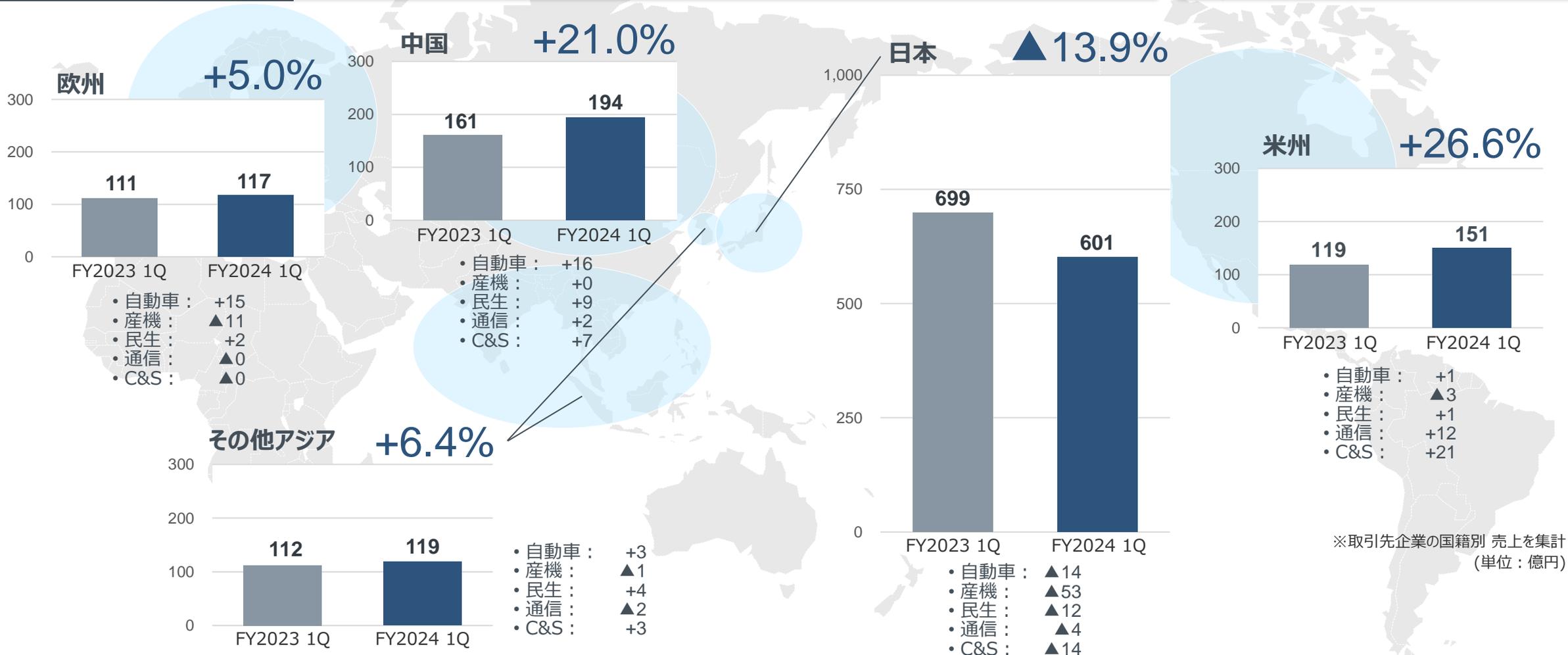
41.9%

FY2023 第1四半期

49.1%

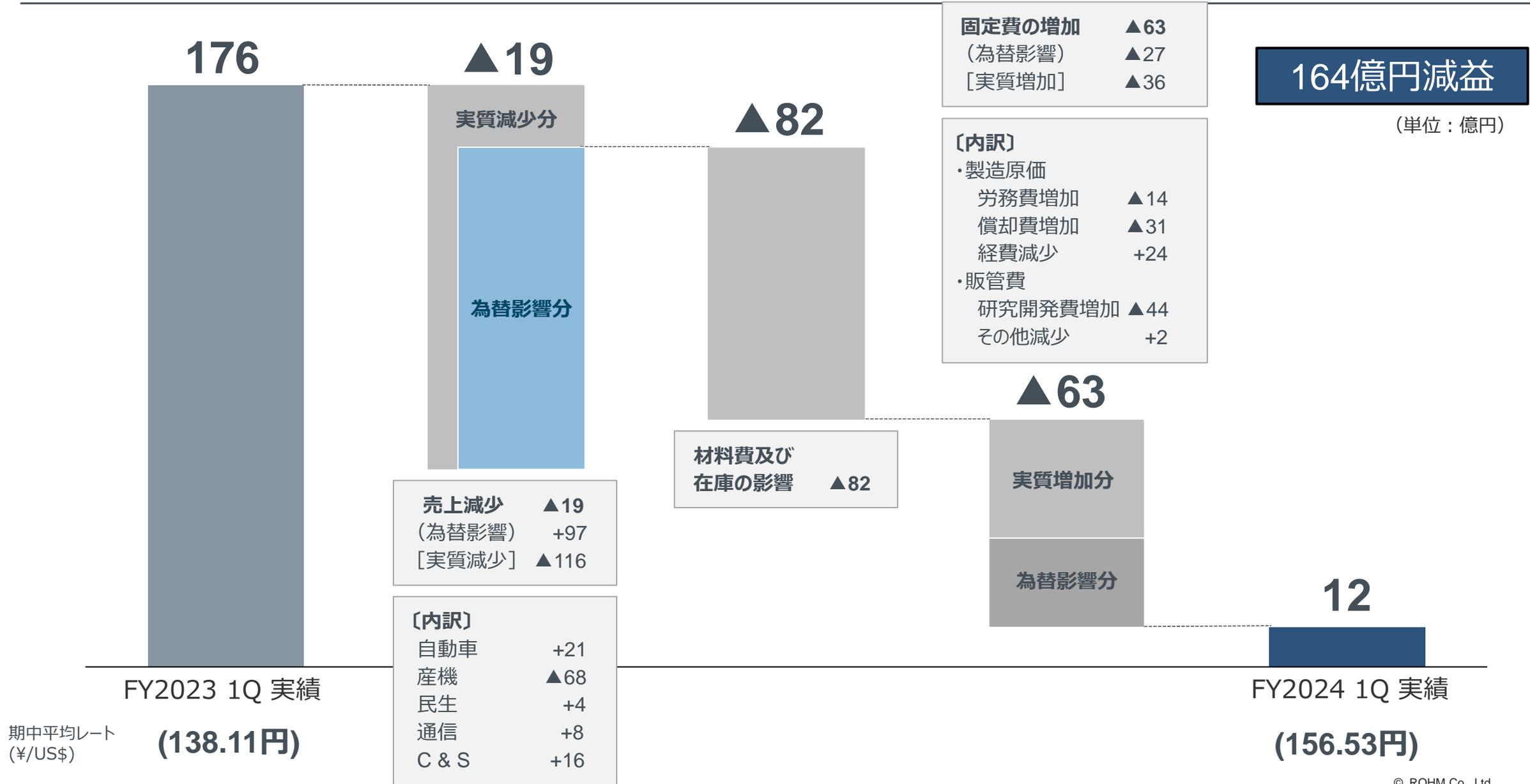
FY2024 第1四半期

第1四半期 前年同期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 第1四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



2024年度 第1四半期 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2024 第1四半期 実績	FY2023 第1四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	537	541	▲4	▲0.7%
	セグメント利益	40	77	▲37	▲48.5%
	(利益率)	(7.4%)	(14.4%)	-	-
半導体素子	売上	489	515	▲26	▲5.1%
	セグメント利益	▲49	77	▲126	▲163.5%
	(利益率)	(▲10.1%)	(15.1%)	-	-
モジュール	売上	89	80	+9	+10.5%
	セグメント利益	7	4	+3	+70.9%
	(利益率)	(8.8%)	(5.7%)	-	-
その他	売上	66	63	+3	+4.4%
	セグメント利益	7	5	+2	+25.7%
	(利益率)	(10.6%)	(8.8%)	-	-

2024年度 第1四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)

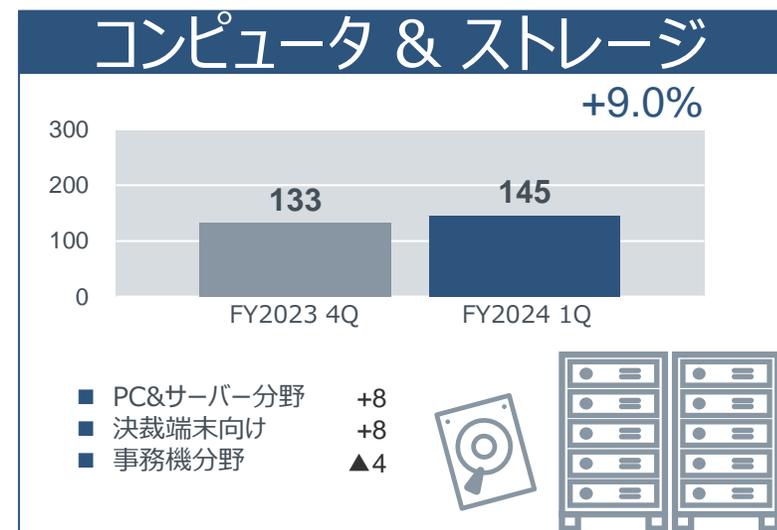
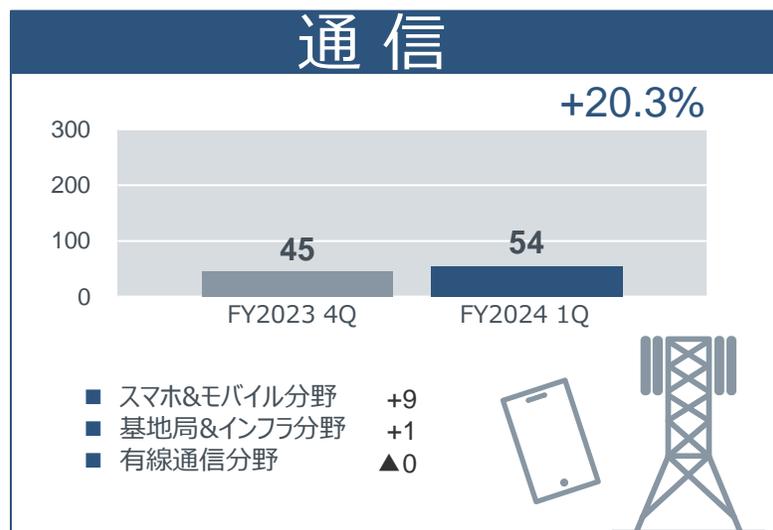
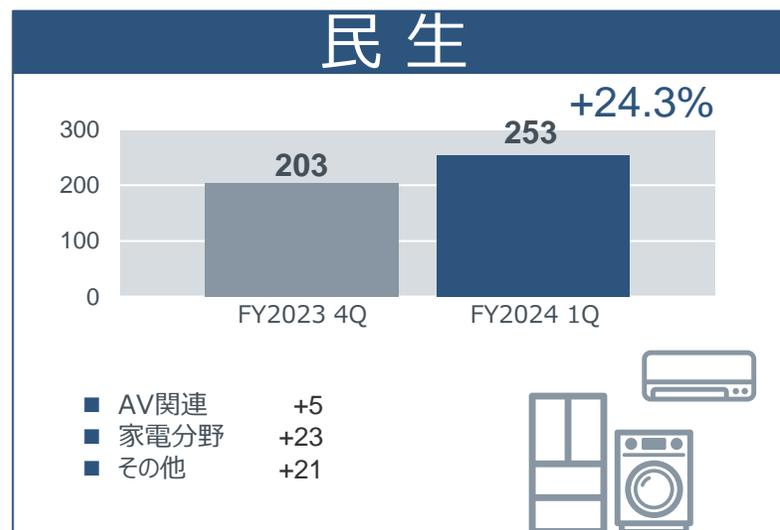
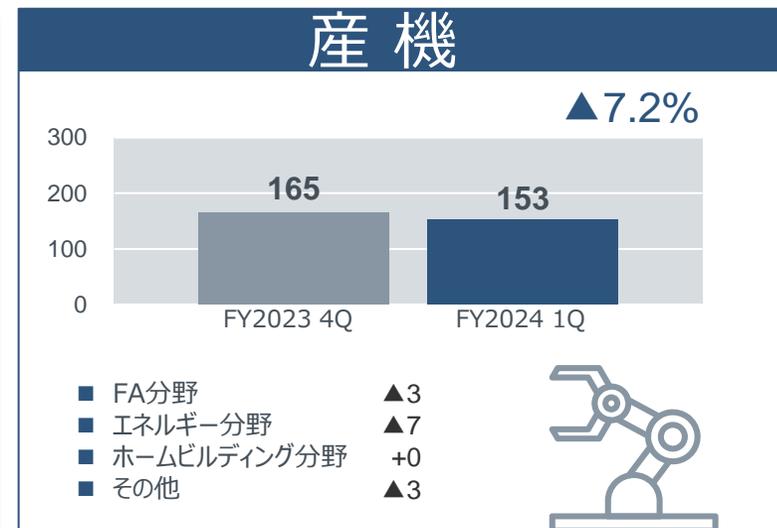
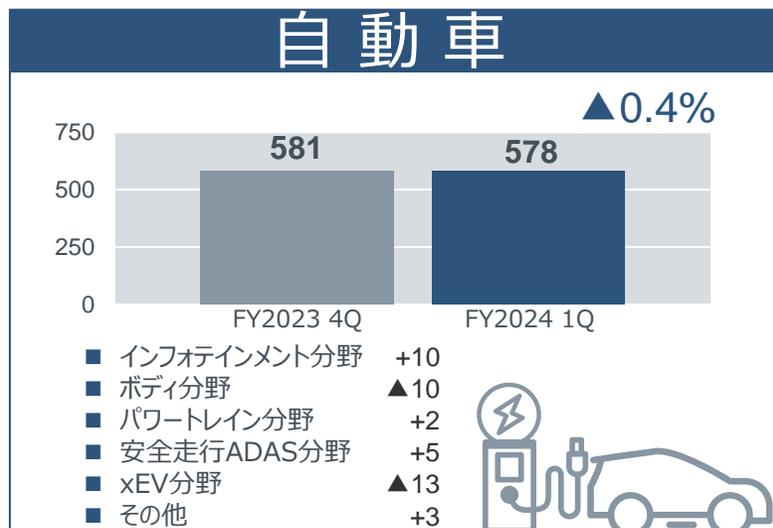
(単位：億円)

	FY2024 第1四半期 実績	FY2023 第4四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,182	1,126	+56	+5.0%
営業利益	12	26	▲14	▲52.5%
(対売上比率)	(1.1%)	(2.4%)	-	-
経常利益	92	90	+2	+1.9%
(対売上比率)	(7.8%)	(8.1%)	-	-
純利益	34	88	▲54	▲60.9%
(対売上比率)	(2.9%)	(7.9%)	-	-
EBITDA	210	238	▲28	▲11.9%
(対売上比率)	(17.8%)	(21.2%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (156.53円) (147.87円)

期末レート(¥/US\$) (161.07円) (151.41円)

(単位：億円)



2024年度 第1四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

四半期売上高

1,126億円

1,182億円

FY2023 第4四半期実績

FY2024 第1四半期実績

+5.0%

海外売上高比率

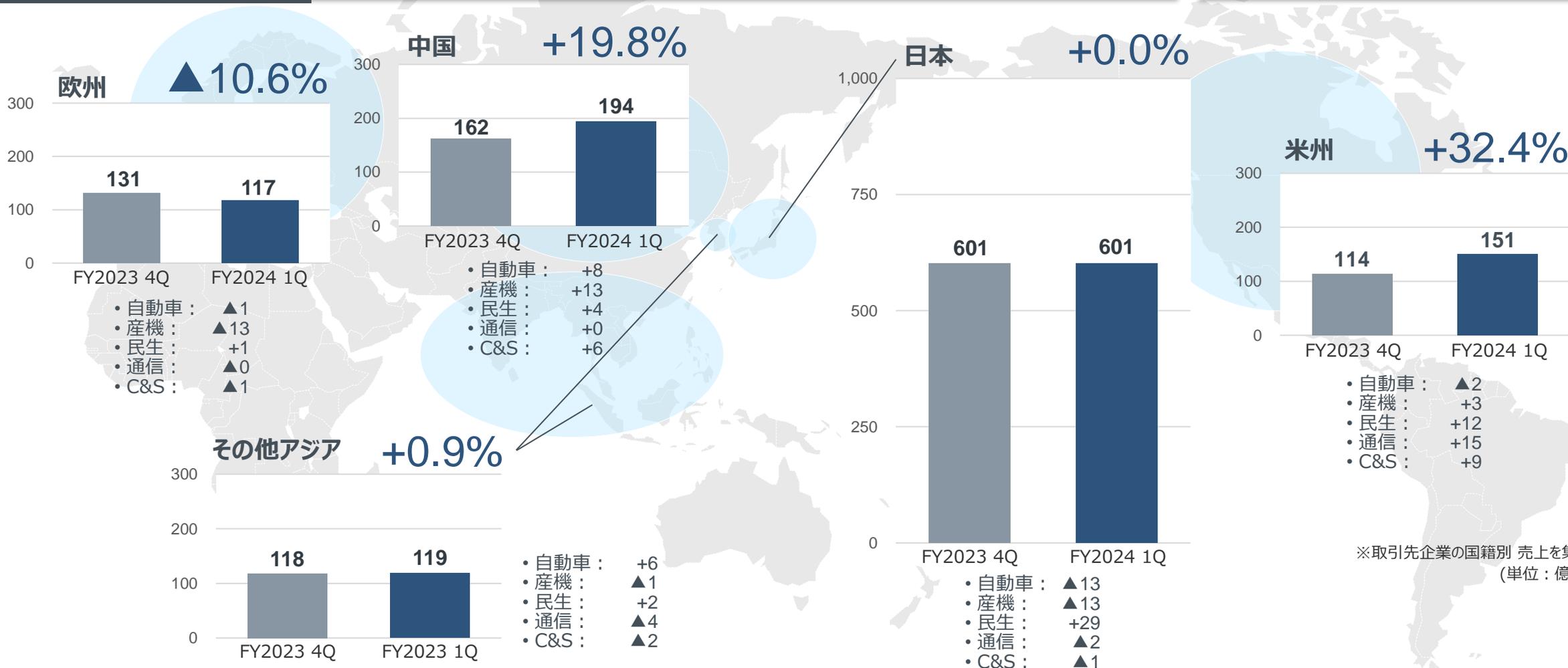
46.6%

FY2023 第4四半期

49.1%

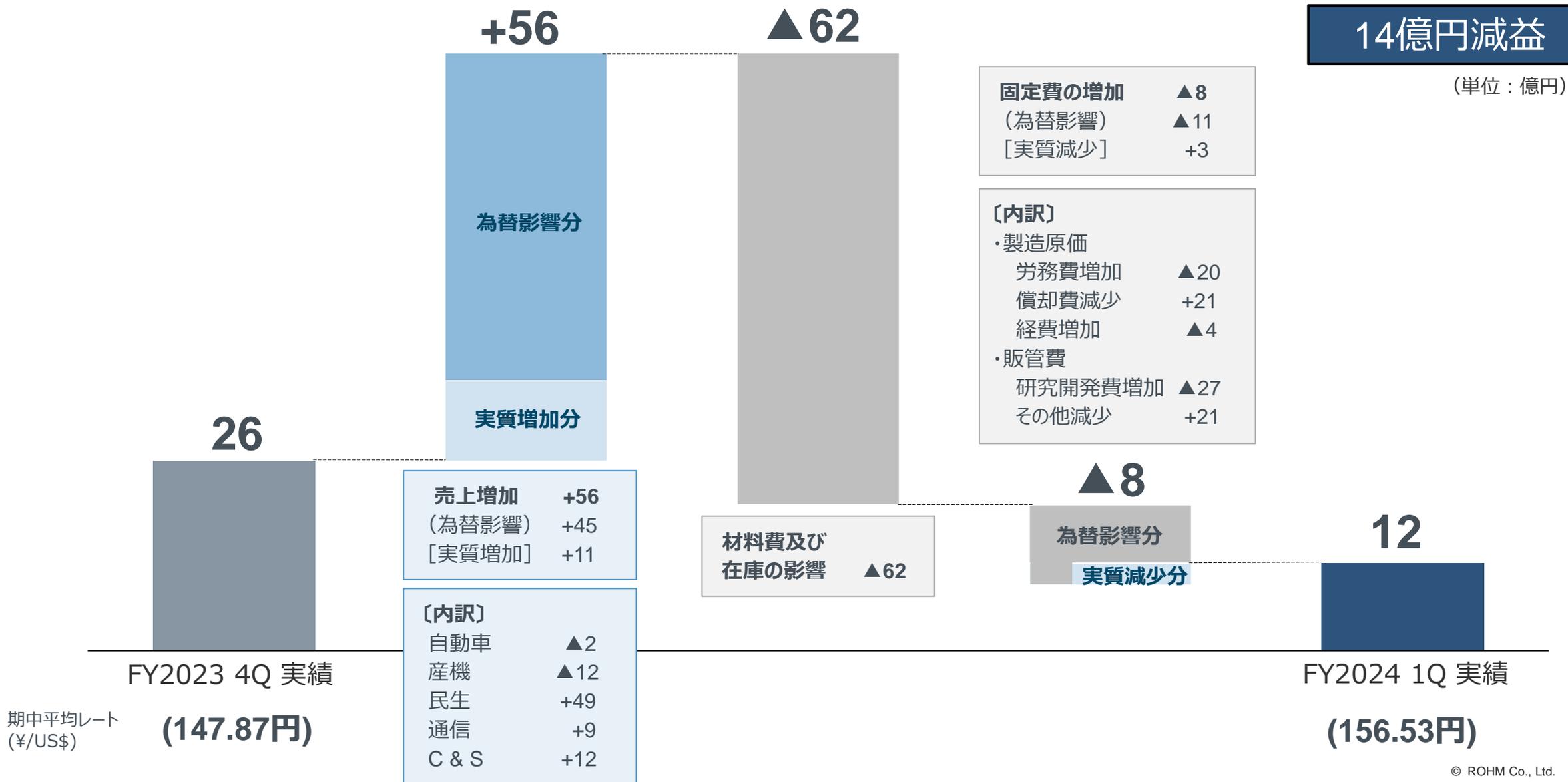
FY2024 第1四半期

第1四半期 直前四半期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 第1四半期 営業利益 増減分析 (直前四半期比)



期中平均レート (¥/US\$)

FY2023 4Q 実績
(147.87円)

FY2024 1Q 実績
(156.53円)

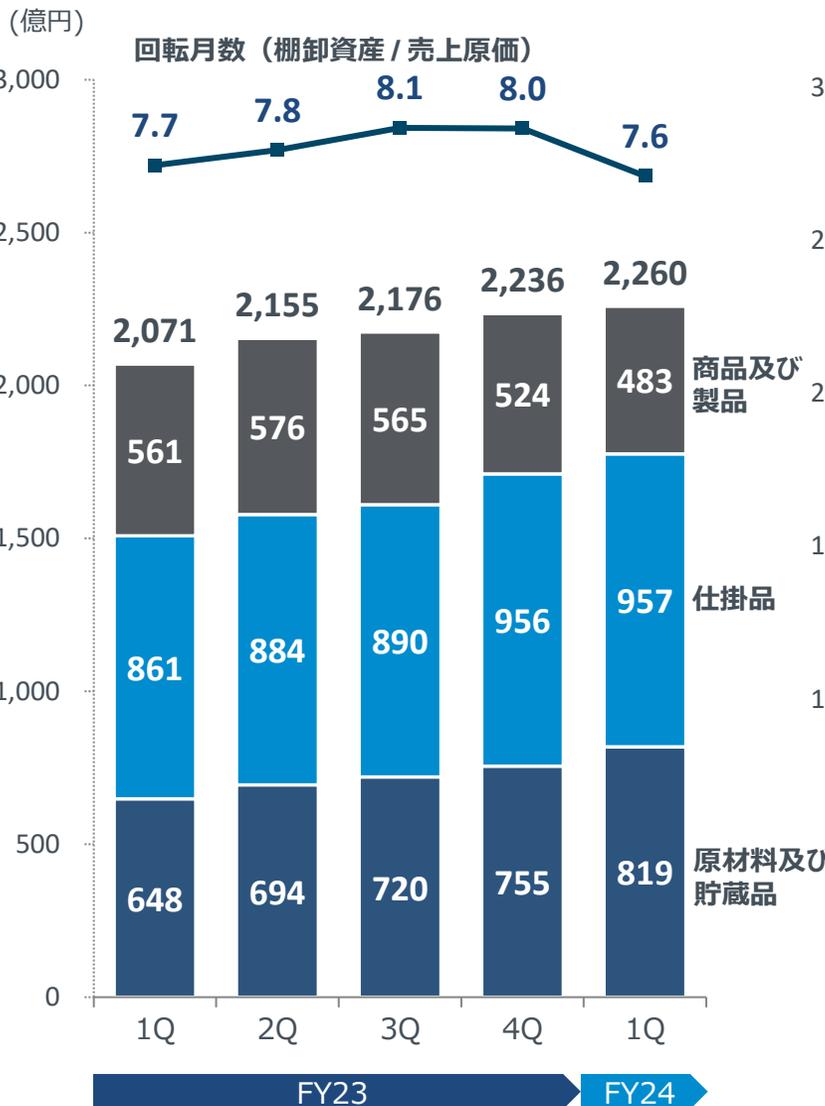
2024年度 第1四半期 セグメント別 (直前四半期比)

(単位：億円)

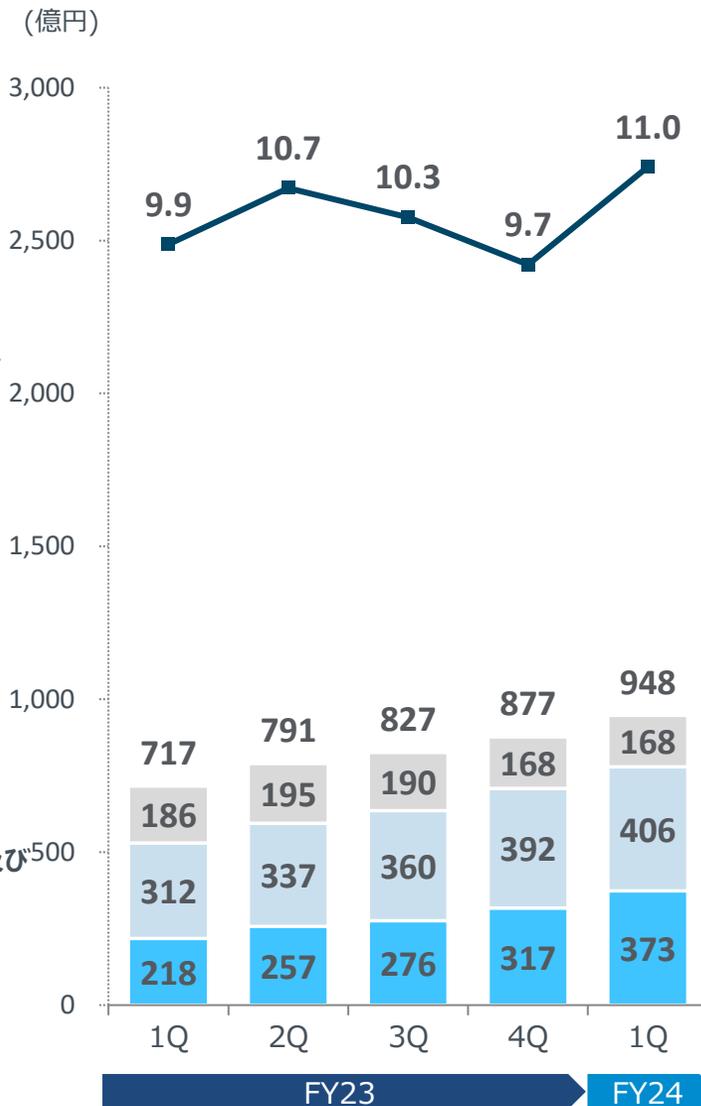
		FY2024 第1四半期 実績	FY2023 第4四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	537	486	+51	+10.4%
	セグメント利益	40	34	+6	+17.4%
	(利益率)	(7.4%)	(7.0%)	-	-
半導体素子	売上	489	503	▲14	▲2.7%
	セグメント利益	▲49	▲15	▲34	-
	(利益率)	(▲10.1%)	(▲3.1%)	-	-
モジュール	売上	89	73	+16	+21.9%
	セグメント利益	7	▲0	+7	-
	(利益率)	(8.8%)	(▲1.2%)	-	-
その他	売上	66	63	+3	+5.0%
	セグメント利益	7	4	+3	+48.0%
	(利益率)	(10.6%)	(7.5%)	-	-

在庫の状況 (金額)

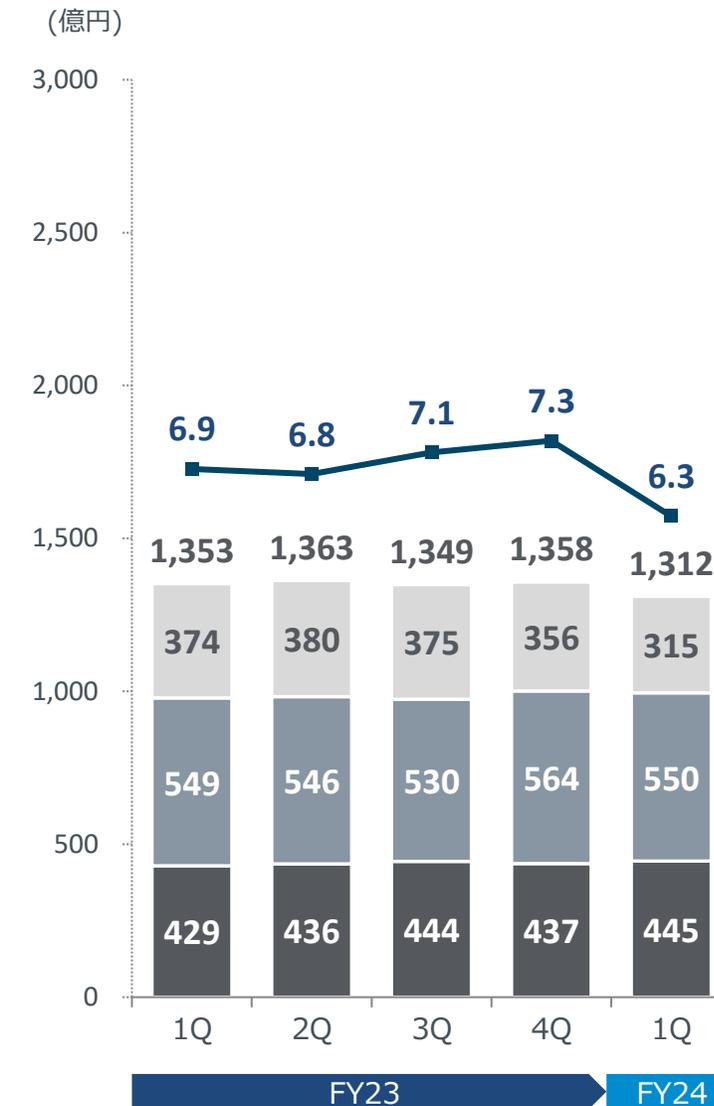
連結合計



パワーデバイス



パワーデバイス以外



通期の業績予想について

【ご参考】 2024年5月8日公表 計画値

(単位：億円)

	FY2024 計画	FY2023 実績	増減額	増減率
売上高	4,800	4,677	+123	+2.6%
営業利益	140	433	▲293	▲67.7%
(対売上比率)	(2.9%)	(9.3%)	-	-
経常利益	180	692	▲512	▲74.0%
(対売上比率)	(3.8%)	(14.8%)	-	-
純利益	140	539	▲399	▲74.1%
(対売上比率)	(2.9%)	(11.5%)	-	-
EBITDA	1,067	1,153	▲86	▲7.5%
(対売上比率)	(22.2%)	(24.7%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$)

(145.49円)

(144.40円)

期末レート(¥/US\$)

(145.00円)

(151.41円)

Question	Answer
1Qの月次売上高は？	4月:404億円、5月:393億円、6月:378億円。なお、為替による決算修正が+8億円発生しております。
稼働率の状況は？ 今後の在庫レベルは？	SiCパワーデバイス以外の製品については稼働を落として生産調整しており、在庫水準の適正化を進めております。製品・仕掛品在庫については、順調に圧縮が進んでおります。 上期中に適正在庫まで圧縮を進め、下期以降は需要の回復と共に稼働率を上げていく計画をしております。
1Qの売上・利益は計画に対してどうだった？	売上に関しては、為替が想定よりも円安に進んだこともあり、各市場計画に対して上振れ、全体として約10%上振れの結果でした。 利益に関しては、売上の増加やSGAの削減効果があったものの、在庫の変動による影響が費用目に出たことから、上振れ幅は限定的でした。
半導体素子部門の利益が赤字になった理由は？	SiCパワーデバイスの生産能力増強のための投資を継続していることによる償却負担増、8インチライン開発のための研究開発費の負担増によるものです。
足元の需要動向は？ 2Q以降の市場別の見通しは？	1Qにおいては計画に対し順調に推移したものの、本格的な回復の兆しは見ておらず、足元の需要動向としては依然として厳しい状況が続いております。2Q以降、各市場向けにおいて市場の回復が想定通りに進むか不透明感が強い状況です。
1QのSiC事業の状況は？	産業機器市場向けに関しては市場の影響により低迷しており、足元で中国EV市場に調整が見られるものの、全体として想定に対して順調に推移しております。FY24におけるSiC事業の年間売上は600億円を見込んでおります。
通期業績の見通しは？	1Qにおいては順調でしたが、2Q以降は不透明感が強く、市場動向に注視する必要があります。今後公表済みの業績予想に変更が必要と判断される際には、改めて業績予想の修正を行います。
為替感応度は？	ドルに対して円安に動くと、業績にはプラスに働きます。 1円動くと、年間ベースで売上高21億円、営業利益8億円変動します。
東芝との協業について進捗は？	予定通り業務提携に向けた協議を開始しております。また決定事項等開示すべき内容が発生すれば、速やかに開示することといたします。

- [2024-05-30 スマートフォンや小型IoT機器などに最適な世界最小CMOSオペアンプを開発](#)
- [2024-06-11 xEV用インバータの小型化に大きく貢献！2in1 SiCモールドタイプ新型モジュール「TRCDRIVE pack™」を開発](#)
- [2024-07-01 エンジニアの困りごとを解決するサイト「Engineer Social Hub™」を開設](#)
- [2024-07-31 自動車のドア、シート等の各種モーターやLEDヘッドライトなどに最適！実装信頼性の高い車載向けNch MOSFETの10機種3パッケージを開発](#)



Electronics for the Future